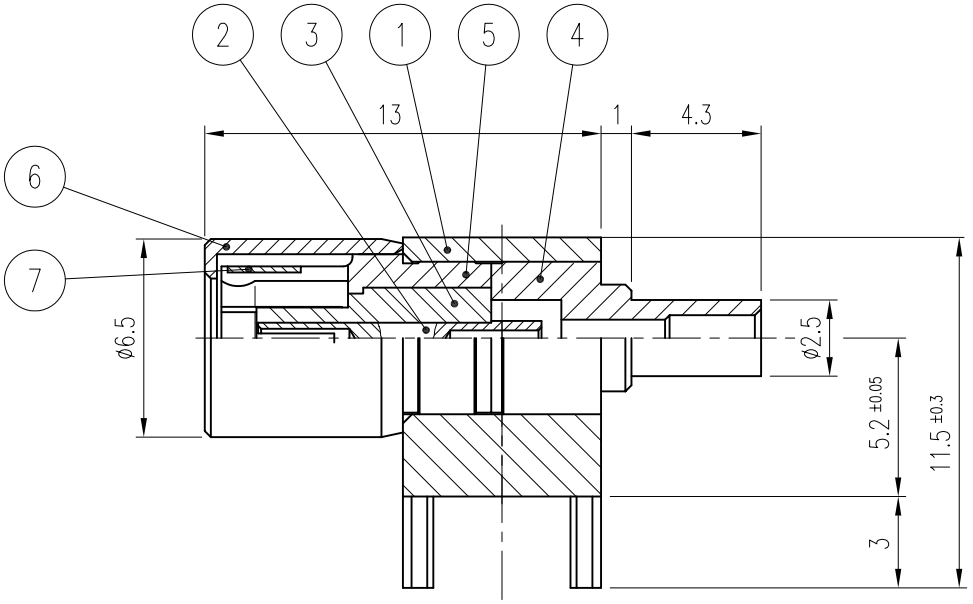
ST \ 기공										
ST(기존)										
ST(개선)										

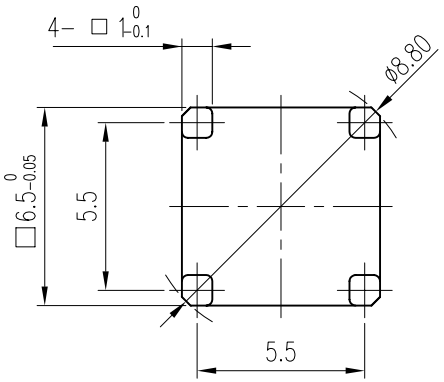
수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
A	INSULATOR 빼짐 방지및 JACK 분리	손윤호	안병호	2004. 04. 01.
B	표준화(Mating 부분)를 삽입력/이탈력 변경 (설변No.연구2005-105) 삽입/이탈력 도면에 기입	김인철	유일환	2005. 05. 13.
OR	업체요구 [설변No.201001-0009] (BODY 비뚤작업 추가 및 FERRULE, JACK 공차변경)	강동우	최영호	2010. 01. 13.



주 기

1. 도금 방법은 전기도금(유광)으로 할것.
2. (B) 삽입력 : 4~10kgf , 이탈력 : 4~10kgf
   (관리 SPEC : 4 ~ 8 kgf 유지)



	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	7	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00005-5/1 (R3004)
	6	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00025-5/1 (K3007)
OR A	5	JACK	1	MBsBD	Nickel Plate	DJA00032-5/2 ~~DJA00032-5/1 (J3023)~~
OR A	4	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00004-5/2 ~~DFE00004-5/1 (F3014)~~
A	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00324-N/1 (H3110)
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00354-5/1 (E3115)
OR	1	사각 BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00469-5/2 ~~DBD00469-5/1 (D3113)~~

대체가능재질	년월일	2010. 01. 13.	KJ COMTECH KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인	Y.H.CHOI	
	검도	I.C.KIM	도명 현대 오토넷 PDA BOARD용 CONN
재질	제도	D.W.KANG	
열처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 CN00218-7/1
보호피막처리	척도 4/1	단위 mm	중량 — K315-672-000